⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-124668

®Int. Cl. 5 G 03 F 7/42 1/00 識別記号

104

庁内整理番号

43公開 平成 4年(1992) 4月24日

C 23 F H 01 L 21/027 7124-2H 7179-4K

7352-4M H 01 L 21/30 3 6 1 R

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

60発明の名称

レジスト用剝離剤組成物

②)特 願 平2-243762

願 平2(1990)9月17日 22出

720発明 者 屋 和正

神奈川県高座郡寒川町一之宮7丁目8番22号

@発 明 者

小 林 政 一

神奈川県茅ケ崎市矢畑75-7

⑫発 明 原田 者 沯 中 庸 一郎 初幸

神奈川県茅ケ崎市浜竹1-10-16 神奈川県茅ケ崎市萩園2722-3-306

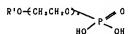
個発 明 Œ 切出 願 人 東京応化工業株式会社

神奈川県川崎市中原区中丸子150番地

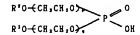
個代 理 人 弁理士 阿 形 外1名

- 1. 発明の名称
- レジスト用剥燵剤俎成物
- 2. 特許額求の范囲

1 (A)有収アミン20~90 貸仕%、(B)一級 式



(式中のR¹は炭菜放8~30のアルキル茲又は アルキルフェニル茲、nは正弦である) 及び一級式



(式中のR'及びR'はそれぞれ炭森放8~30の アルキル茲又はアルキルフェニル茲であり、それ らは同一であってもよいし、具なっていてもよく、 p及びqはそれぞれ正弦であり、それらは同一で あってもよいし、具なっていてもよい) で表わされるリン酸エステル系昇面括性剤の中か ら遅ばれた少なくとも1 粒0.1~20 柱丘%、(C) 2-ブチン-1.4-ジオール0.1~20丘丘%、及 び段部が(D)-殴式

HO-(CH,CH,O)-R'

(式中のR'は炭森放1~5のアルキル茲、mは 1、2又は3である)

で設わされるグリコールモノアルキルエーテル及 び邦プロトン性紅性溶剤の中から混ばれた少なく とも「粒から成るレジスト用到点剤粗成物。

2 非プロトン性抵性溶剤がジメチルスルホキシ ド、N.N-ジメチルアセトアミド、N.N-ジメチル ホルムアミド、N-メチル-2-ピロリドン及びN. N-ジメチルイミダソリジノンである顕求項1包 以のレジスト用剝離剤組成物。

3. 発明の詳細な説明

庭以上の利用分野

本発明は近鏡なレジスト用別感剤組成物、さら に詳しくは、エッチング処型などで変質したレジ ストパターンに対しても十分な例感性を育すると ともに、水洗時や吸退によるアルミニウムや回茲 体などに対する瓜食性が低く、かつ作意現址に思 影響をもたらすことがない上、リンス処理も水洗 のみでよいなど、極めて実用的なレジスト用剥離 剤組成物に関するものである。

従来の技術

従来、トランジスタ、IC、LSIなどの半導体デバイスはホトエッチング法によって製造されている。このホトエッチング法によると、該半導体デバイスは、例えばシリコーンウエハーなどの無機質基体上に、ホトレジスト層を形成し、その上に所望のパターンを有するマスクを重ねて露光し、現像処理を施すことでレジストパターンを形成させたのち、このレジストパターンをマスクとして、質出した無機質基体に対してエッチング処理や拡散処理を行い、次いで該レジストパターンを無機質基体から剥離除去することにより得られる。

この際用いられるホトレジストには、オガ型とポジ型とがあるが、主として散細パターンの形成に有利なポジ型ホトレジストが用いられている。このポジ型ホトレジストは、一般にフェノールーアルデヒド樹脂と感光剤とから成るものであって、

しかしながら、このような水溶性の剥離形においては、水洗時、特に優せき法による水洗時に、 放分の有機アミンが解離してアルカリ性を呈し、 アルミニウムや銅などに対して腐食性を有するため、アルミニウムや銅から成る基体上に設けられたレジストパターンの剥離には、アルコール系の 有機溶剤によるリンス処理を必要とし、また、剥離液の吸湿により、 該有機アミンが解離して、 微細化の進む半導体デバイスの製造においてごく 値 かでも針ましくないアルミニウムや銅薬体の腐食をもたらすおそれがあるなどの問題を有している。

このような問題を解決するために、有機アミンを含有せず、グリコールモルアルキルエーテルや 非プロトン性極性存剤のみから成る剝離剤を用いる場合、エッチング処理などで変質したレジスト パターンに対しては剥離性が十分でないという問題が生じる。

発明が解決しようとする課題

本発明は、このような従来のレジスト用剥離剤 が有する欠点を克服し、エッチング処理などで変 このようなポジ型ホトレジストから形成されるレジストパターンを剥離除去するための剥離剤としては、従来、フェノール又はその誘導体とアルキルベンゼンスルホン酸及び塩素系有機器剤から成る溶液が用いられてきた。

しかしながら、このような剥離剤においては、フェノール系化合物や塩素系有機溶剤を含有しているため、毒性があり、廃液処理などに問題がある上、非水溶性であるために剥離処理後のリンス工程が煩雑になるのを免れず、さらに使用するアルキルベンゼンスルホン酸が高吸湿性のため酸性を呈し、下地配線層を腐食しやすいなどの欠点があった。

したがって、このような欠点を改良するために有機アミンと、グリコールモルアルキルエーテル 又は非プロトン性種性溶剤、例えばジメチルスルホキンド、N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン 及びN,N-ジメチルイミダゾリジノンなどとから 成る水溶性の剥離剤が開発され、市販されている。

質したレジストパターンに対しても十分な剥離性を有するとともに、水洗時や吸湿によるアルミニウムや鋼基体などに対する腐食性が低く、かつ作業環境に悪影響をもたらすことがない上、リンス処理も水洗のみでよいなど、実用的なレジスト用剥離剤組成物を提供することを目的としてなされたものである。

際題を解決するための手段

本発明者らは、前記の好ましい性質を育するレジスト用剝離剤組成物を開発すべく鋭意研究を重ねた結果、特定の割合の有機アミンとある種のリン酸エステル系界面活性剤と2-ブチン-1.4-ジオール、及びグリコールモルアルキルエーテルや非ブロトン性極性静剤から成る組成物により、その目的を達成しうることを見い出し、この知見に裏づいて本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は、(A)有機アミン20~90 重量%、(B)一般式

(式中のR'は炭素数8~30のアルキル茲又は アルキルフェニル苺、nは正数である) 及び一般式

(式中のR*及びR*はそれぞれ炭森致 8~30の アルキル基又はアルキルフェニル基であり、それ らは同一であってもよいし、異なっていてもよく、 p及び q はそれぞれ正歓であり、それらは同一で あってもよいし、異なっていてもよい)

で扱わされるリン酸エステル系界面活性剤の中から起ばれた少なくとも1 缸0.1~2 0 重量%、(C)2-ブチン-1.4-ジオール0.1~2 0 重量%、及び換部が(D)一般式

(式中のR*は炭経数1~5のアルキル基、mは1、2又は3である)

で表わされるグリコールモノアルキルエーテル及 び非プロトン性低性溶剤の中から退ばれた少なく とも 1 粒から成るレジスト用到低剤組成物を提供 するものである。

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明担成物における(A)成分の有収アミンとしては、第一級、第二級、第三級の脂肪族アミン、

脂取式アミン、 芳香族アミン、 紅森眼式アミンの

いずれも用いることができる。 第一級脂肪族アミ

ンとしては、 例えばモノエタノールアミン、 エチレンジアミン、2-(2-アミノエトキシ) エタノール

などが、 第二級脂肪族アミンとしては、 例えばジエタノールアミン、 イミノビスプロビルアミンなどが、 第三級脂肪族アミンとしては、 例えばジェチルアミノエタノールなどが好ましく 挙げられる。また、 脂裂式アミンとしては、 例えばンクロヘキシルアミン、 ジシクロヘキシルアミン などが、 芳香族アミンとしては、 例えばベンジルアミン、 グペンジルアミン、 N-メチルベンジルアミン な

これらの有限アミンは! 紅用いてもよいし、2 紅以上を組み合わせて用いてもよく、また、その 含有量は組成物全盤量に基づき20~90度量% の範囲にあることが必要である。この量が20度 量%未費では到底性に劣るし、90度量%を超え ると保存安定性が懸くなり、突用的でない。

本発明組成物においては、(B)成分として、一般式

(式中のR¹及びn前配と同じ意味をもつ) 及び

(式中のR¹、R¹、p及びqは的記と同じ意味を もつ)

で絞わされるリン酸エステル系界面活性剤の中から辺ばれた少なくともl値が用いられる。

このようなリン酸エステル系界面括性剤として は、例えばアデカコールPS-440E、PS~50gE (い ずれも旭冠化工数(株)段、商品名)、Gafac RB-410(双邦化学工数(株)段、商品名)などが市販されている。

どが、収容収式アミンとしては、例えばN-ヒド

ロキシエチルピペリジン、1.8-ジアザビシクロ

(5,4,0)-7-ウンデセンなどが挙げられる。

この(B)成分のリン酸エステル系界面括性剤は 1 短用いてもよいし、2 哲以上を組み合わせて用 いてもよく、またその含有企は組成物全立性に基 づき0.1~2 0 及登%、好ましくは0.2~1 0 登登 %の塩田にあることが必要である。この登が0.1 登登分割では吸避による有限アミンの保障によっ て生じるアルミニウムや飼益体へのごく値かな原 食を低減させる効果が十分に発揮されないし、20 登別を超えると剝離性が低下する。

本発明組成物においては、(C)成分として2-ブチン-1.4-ジオールが用いられるが、このものの含有量は、組成物全資量に該づ80.1~20 取量%、好ましくは0.2~10 可量%の範囲にあることが必要である。この量が0.1 可量%未到では、前配(B)成分と同概吸過による有級アミンの
の同によって生じるアルミニクムや同誌体へのこく個かな月食を低減させる効果が十分に発知され ないし、20重量%を超えると剝離性が低下する。 本発明組成物においては、(D)成分として、一 般式

(式中のR*及びmは前記と同じ意味をもつ) で表わされるグリコールモノアルキルエーテル及 び非プロトン性極性溶剤の中から選ばれた少なく とも1種が用いられる。

前記一般式(皿)で表わされるグリコールモノアルキルエーテルとしては、例えばエチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテルなどを許ましく挙げることができる。

また、非プロトン性極性溶剤としては、例えば ジメチルスルホキシド、N,N-ジメチルアセトア ミド、N,N-ジメチルホルムアミド、N-メチル-2-ピロリドン、N,N-ジメチルイミダゾリジノン などを好ましく挙げることができる。

本発明組成物においては、数(D)成分の溶剤と

剥離剤組成物を用いて除去処理する。この除去処理には、通常従来慣用されている役せき法が用いられる。除去処理後、水洗いによるリンス処理を施すことで、レジストパターンが完全に除去された高品質の基体を得ることができる。該リンス処理においては、必要に応じ、まずアルコールやケトンなどを用いて洗浄したのち、水洗してもよい。

また、該基体としては、例えばシリコーンウエハーの他に、望化ケイ素、ガリウム・ヒ素、鋼、酸化クロム、ニッケル、クロム、アルミニウム、インジウム、チタン酸化膜などの被膜を有するものが挙げられる。

発明の効果

本発明のレジスト用到離利組成物は、エッチング処理などで変質したレジストパターンに対しても十分な剥離性を有するとともに、水洗時や吸湿によるアルミニウムや銅基体などに対する腐食性が低く、かつ作業環境に悪影響をもたらすことがない上、リンス処理も水洗のみでよいなど、実用的価値が極めて高い。

して、前記のグリコールモノアルキルエーテルを | 種又は2種以上組み合わせて用いてもよいし、 非プロトン性極性溶剤を | 種又は2種以上組み合 わせて用いてもよく、あるいはグリコールモノア ルキルエーテル!種以上と非プロトン性極性溶剤 | 種以上とを組み合わせて用いてもよい。

本発明のレジスト用剥離剤組成物を適用しうるホトレジストとしては、例えばノボラック樹脂とキノンジアジド系の光分解剤とを含有して成るものを舒ましく挙げることができるが、特にクレゾールノボラック樹脂とナフトキノンジアジド系の光分解剤との組合せから成るボジ型ホトレジストが好道である。

次に、本発明のレジスト用剥離剤組成物の使用 方法の1例について説明すると、まず基体上に設けられたホトレジスト層に、活性光線を用いて顕像形成露光を施したのち、現像処理して基体上にレジストパターンを形成し、次いでこのレジストパターンをマスクとして基体をエッチング処理したのち、基体上に喪在するレジストパターンを聴

実施例

次に実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってなんら限定されるものではない。

実施例1~8、比較例1~5

シリコーンウェハー上に、密着性付与剤を盤布したのち、クレゾールノボラック樹脂とナフトキノンジアジド基含有化合物とを含有して成るボジ型ホトレジストのOFPR-800(東京応化工業社製)を3.0μ≡の厚さで盤布し、110℃で90秒間ホットプレート上で乾燥させたのち、このレジスト層にマスクを介して紫外線を選択的に照射し、次いで現像処理してレジストパターンを有するシリコーンウェハーを得た。

次に、このようにして得られたレジストバターンを有するシリコーンウエハーに対し、それぞれ(a)180℃での加熱処理、(b)Crエッチング処理を施して、サンブル(a)及びサンブル(b)を作成した。次いで、サンブル(a)、(b)を、第1妻に示す組成の到離液(100℃)中に所定時間長せき

したのち、純木でリンス処理したものについて、 剥離状態を観察し、次の判定基準に従って剥離性 を評価した。

判定基準

- ◎: 後せき時間2分以内に剥離されている。
- 〇:浸せき時間が2分を超え5分以内に剥離 されている。
- △:畏せき時間が5分を超え | 0分以内に剝離されている。
- ×:剥離するのに | ()分より長い浸せき時間 を要す。

また、透明なガラス板上にアルミニウムを蒸着 して得たアルミニウム基体を、到離液の10重量 %水溶液に40℃にて優せきし、アルミニウムが 安全に熔解するまでの時間を測定し、剥離液のア ルミニウム腐食速度を求めた。

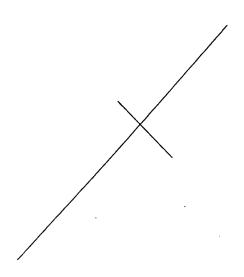
第 1 表

		1	劃	#	疲	組成(武量%)		#1 #	E 12	10=1%水溶液のアル
		有機でミン		リン酸エステル 系活性剤		2-ブチン- 1.4-ジオール	帝 莉		(100%)		ミニウム刺離速度
		種 類	±	種類	1	4	植類	#	(a)	(b)	(A/min)
実	ı	モノエタノールアミン	70	RB - 410	5	5	ジエチレングリコール モノブチルエーテル	20	0	0	5>
	2	N-ヒドロキシ エチルピペラジン	3 0	PS - 509E	5	5	ジメチルスルホキシド	60	0	0	5>
	3	DBU	3 0	PS - 440E	5	5	ジメチルスルホキシド	60	0	0	5>
施	4	モノエタノールアミン	5 0	PS - 440E	2 0	2 0	ジェチレングリコール モノブチルエーテル	10	0	Δ	5>
	5	モノエタノールアミン	70	PS - 440E	10	0 1	ジメチルスルホキシド	10	0	0	5>
	6	モノエタノールアミン	7 0	RB - 410	5	5	N·メチル・2-ピロリドン	20	0	0	5>
91	7	モノエタノールアミン	70	PS - 509E	5	5	N,N-ジメチルイミダ ゾリジノン	20	0	0	5>
	8	2-(2-アミノエチル アミノ)エタノール	7 0	RB - 410	5	5	ジメチルスルホキシド	2 0	0	0	5>
比	ı	モノエタノールアミン	7 0	-	-	-	ジエチレングリコール モノブチルエーテル	3 0	0	0	7 6
較	2	N - ヒドロキシ エチルピペラジン	3 0	-	-		ジメチルスルホキシド	70	0	0	7 4
	3			-	-	-	N-メチル-2-ピロリドン	100	×	×	5>
91	4	モノエタノールアミン	3 0	RB - 410	5	-	ジメチルスルホキシド	65	0	0	7 3
	5	モノエタノールアミン	3 0	-	_	5	ジメチルスルホキシド	6.5	0	0	6 8

- (注) DBU:1.8-ジアザビシクロ (5.4.0)-7-ウンデセン
 - リン酸エステル系活性剤

アデカコールPS-40E、PS-509E(旭電化工業(株)製、商品名) Gafac RB-410(東邦化学工業(株)製、商品名) 更施例9~11、比較例6~8

第2 表に示す組成の剥離液を鋼製し、この剥離液の10 重量%水溶液に60℃にて厚さ約10 μ m の網片を360分間優せきしたのち、取り出し、優せき前後の網片の重量を測定し、重量の減少量を求めた。その結果を第2 表に示す。



第 2 表

			3 1	ME	液	組 皮(重量%)			10g1%水溶液中の
		有機でも	リン酸エステル 系活性剤		2- ブチン- 1.4-ジオール	存 利		網片の重量減少量	
		租無	#	推算	•	±	1 類	#	(# g)
	9	モノエタノールアミン	7 0	PS - 440E	5	5	ジメチルスルホキンド	20	4
奥施	10	モノエタノールアミン	7 0	PS - 509E	5	5	ジエチレングリコール モノプチルエーテル	2 0	5
Ħ	11	2-(2-アミノエチル アミノ)エタノール	7 0	RB - 410	10	10	N-メチル-2-ピロリドン	10	4
比	6	モノエタノールアミン	7 0	-	-	_	ジメチルスルホキシド	3 0	1 2
較	7	モノエタノールアミン	7 0	PS - 440E	5	-	ジメチルスルホキシド	2 5	9
91	8	モノエタノールアミン	7 0	-	-	5	ジメチルスルホキシド	2 5	7